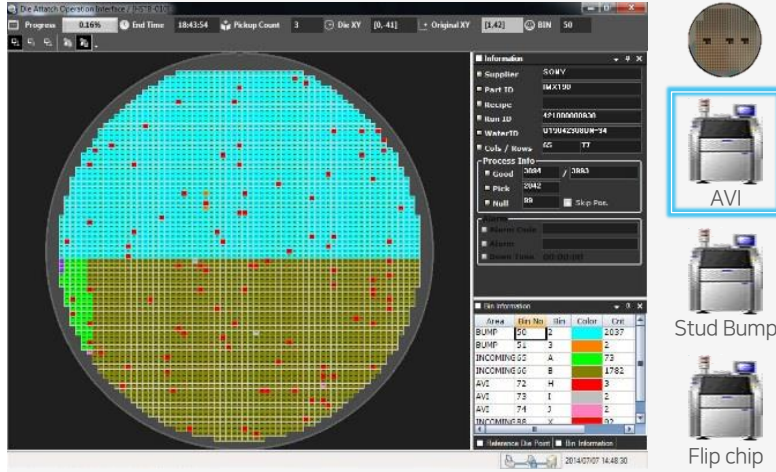


웨이퍼맵 자동화 시스템

Camera, Image Sensor, Wafer Map, Stud Bump, Gold Wire, Flip Chip Bond, AOI



Project Description

- 고객 : 카메라 모듈 생산 업체
- 솔루션 : DAcruX, WaferMap
- 범위 : Stud Bump, Flip chip Bond, AVI

01 The Challenge

- 생산된 제품의 양품 신뢰성 미확보
- Wafer상태의 카메라 센서 전체에 대한 공정 진행으로 품질/생산성 저하, 원가 증감
- Wafer Map 자동화 시스템 부재로 Manual Download 진행에 의한 품질사고
- 생산데이터 공유, 실시간 모니터링 부재

02 The Solution

- AVI I/F 및 Wafer Map Merge로 불량 자동 선택 생산
- 설비 자동화 제어에 의한 Wafer Map 자동 다운로드 및 생산성 증가
- 자동화된 설비제어로 품질 신뢰성 확보
- 생산데이터 현황공유 및 실시간 생산 모니터링 확보

03 Benefits

- 양품 선택생산에 의한 원가절감
- 자동화된 설비 제어에 의한 생산설비의 자동 생산체계 확보
- 불량센서 사전 검출로 인한 완제품 수율증가에 의한 고객신뢰 확보로 물량 증가
- 실시간 생산현황 공유 및 모니터링에 의한 사전 이상 감지체계 확보